

2024年6月13日

各 位

会 社 名 T O W A 株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 岡田 博和  
(コード番号 6315 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長 中西 和彦  
TEL (075) 692 - 0251

## 「半導体・オブ・ザ・イヤー2024」グランプリを受賞

当社の生成 AI 向け半導体の生産に最適なモルディング装置「YPM1250-EPQ」が、株式会社産業タイムズ社主催の「半導体・オブ・ザ・イヤー2024」半導体製造装置部門において、グランプリを受賞いたしました。

今回で第30回を迎える「半導体・オブ・ザ・イヤー」は、株式会社産業タイムズ社が発行する電子デバイス産業新聞が毎年開催しており、開発の斬新性、量産体制の構築、社会に与えたインパクト、将来性などを基準に、最新エレクトロニクス製品の開発にあたり最も貢献した製品や技術が選定されます。

今回、当社がグランプリを受賞した「YPM1250-EPQ」は、今後、高い成長が見込まれるチップレット製品に対応した業界初の装置です。また、新たに開発したモルディング技術である「レジンフローコントロール方式」を採用しており、後工程での先端パッケージング技術による半導体の高機能化や高性能化が求められる中、市場のニーズに応える新製品である点が高く評価されました。

今後も当社は産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、クォーター・リードに徹した「新製品・新商品」の創成に向け、果敢に挑戦し、半導体業界の発展に貢献して参ります。

以上



授賞式の様子



YPM1250-EPQ